2010 日韓部品・素材商談会 参加申込書

<商談を希望する韓国企業>

→各企業の商談案件は、HP(http://www.osaka.cci.orjp/b/gci-kor2010/) をご参照ください!

No.	企業行	2(商談内容)	No.	企業行	名(商談内容)
1	ウヤン貿易	(金属・電気資材)	11)	ジェイス	(自動検査装置)
2	光州() 7 737	(LED E3"1 11)	12	ダサ・ロボット	(産業用ロボット開発・製造)
3	世紀精密	(半導体リードフレーム)	13)	ビー・エイチ・セミ	コン(セラミック部品素材)
4	韓一精密鋳造	(精密鋳造(ロストワックス鋳造)	14)	珍永テック	(機械部品加工、組立)
5	ソクジンエンジニ	アリング(電子部品)	15)	スノゼン	(界面活性剤、ポリマー技術)
6	ミガォン精密	(コンピュータ部品)	16	プロテック	(自動化設備、産業用ロボット)
1	ドンゴァンヘビー	-テック(発電機)	10	T&Bナノイレク	(ナノ粒子のコーティング)
8	フサン	(LED 映像検査機)	18	クムナム精密	(半導体金型設計・製作)
9	ガンコミョンハ	(アルミニウム板金)	19	ソンホ電子	(精密機器用フィルムコンデンサ)
10	エムティアイジー	- (千タニウム加工、製造)	20	セイウン機械	(トロリーコンベア部品)

<商談のお	

Tel

E-Mail

(商談時間は1社につき30~60分程度です。また、都合によりご希望に添えないこともあります。予めご容赦ください)

面談希望韓国企業No. :

	(韓国企業の番号(上記表中の1~20)をご記入ください〈複数可〉)							
面談希望の時間帯		□10:00~12:00		□13:00~14:30		□14:30~17:00		
		(ご都合の良い時間帯の口にチェックを入れて下さい<複数可>)						
			ı					
貴社名			貴社HI	P				
ご参加者氏名								
(お役職)	()					
所在地								

Fax

なお、ご記入いただいた情報は、参加を希望する日本企業側名簿として上記主催団体で共有するほか、個別ミーティングを希望する韓国企業へは、日本企業名とそのURLを事前通知することがあります。また上記主催団体からの各種連絡・情報提供(E-MAIL 含む)のために利用します。

@